1.9 BJT

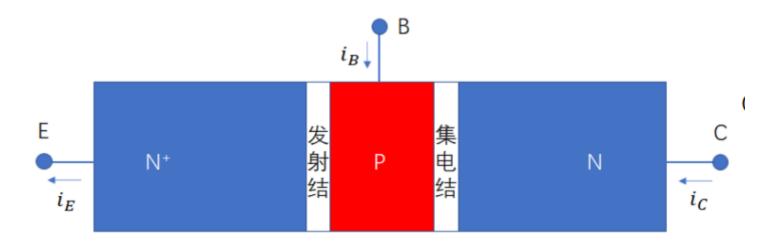
Core Concepts:

- 1.BJT控制机制与特性
 - 1.1恒流区特性方程
- 2.分段折线模型
- 3.分压偏置电路分析
 - 3.1极简偏置
 - 3.2并联负反馈
 - 3.3串联负反馈分压偏置电路
- 4.负反馈电路连接方式与灵敏度分析
- 5. 电流源
 - 负反馈连接改善电阻特性
 - 电流镜
 - 负反馈电路提高厄利电压从而提高匹配程度
 - β倍增器提高匹配程度
- 6.NPN-BJT与PNP-BJT对比

本次笔记若无特别说明,默认以NPN-BJT为例

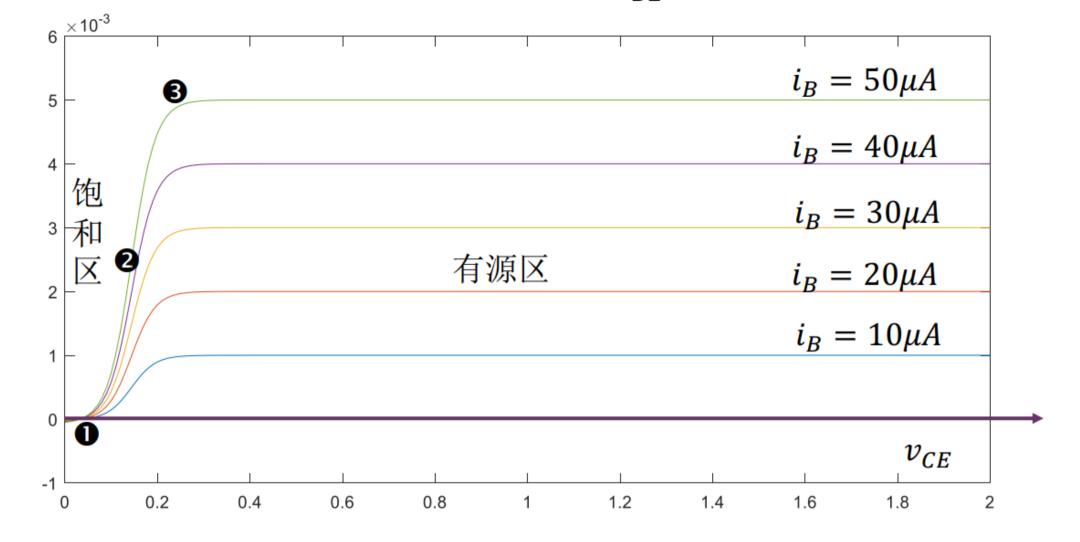
1.BJT控制机制与特性

以NPN-BJT为例:



NPN-BJT

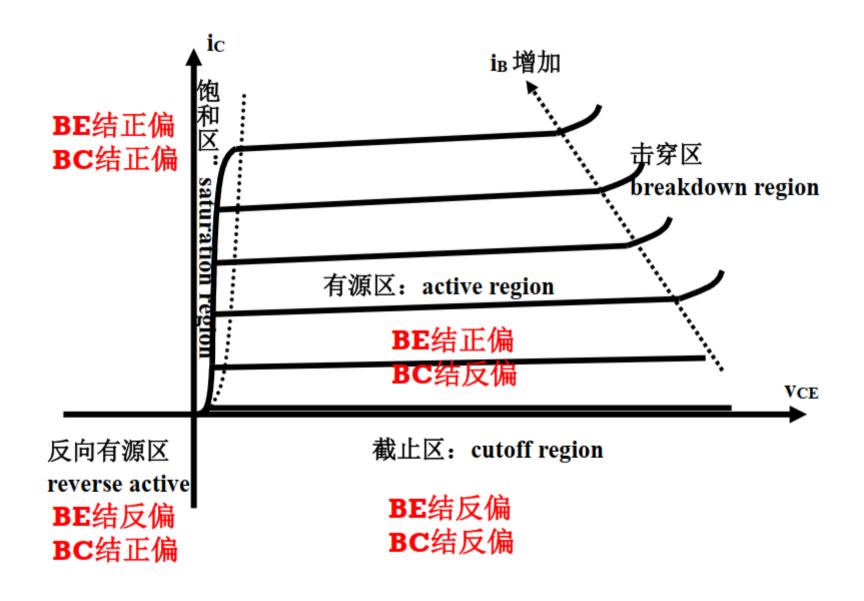
- 当 $i_B=0(V_{BE}=0)$ 时 V_C 加正电压 $(V_{CE}>0)$ 没有电流,处于截止区
- 当 $i_B>0$ 时,从 N^+ 向P流入大量电子,在非常薄且掺杂浓度非常低的P区尚未复合就流入N区,这时候随着 V_{CE} 的增大 I_C 也在增大,当 $V_{CE}>V_{CE,sat}=0.2V$ 时, I_C 达到饱和,此时 $I_C=\beta I_B$ 所以呈现下图的伏安特性曲线:



注意如果把 I_B 作为控制变量,饱和电流和 I_B 呈现线性关系(可以看作一个线性的流控流源)

PS:我们认为"在恒流区时,BC的PN结反偏截止"实际上是一种抽象:因为随着 V_{CE} 的增加,靠近 V_{CB} 这块区域的电子浓度是越来越小的,因此当 $V_{CE}=0.2V$ 时,这部分的电子浓度太小了以至于我们可以近似认为截止了(其实仍然可以导电,并且 $I_C=\beta I_B$)

恒流区特性方程 (glgg强调一定要记住,并且实际体验是还要能在所给的图中找到对应的变量是什么)



$$egin{align} i_B = A_J J_{BS0} igg(e^{rac{v_{BE}}{v_T}} - 1igg) \ i_C = eta A_J J_{BS0} igg(e^{rac{v_{BE}}{v_T}} - 1igg) igg(1 + rac{v_{CE}}{V_A}igg) = eta i_B igg(1 + rac{v_{CE}}{V_A}igg) \end{aligned}$$

其中一些符号的含义如下:

 $v_T = \frac{kT}{q}$:热电压; V_A :厄利电压;

 $I_{BS0} = A_J J_{BS0}$: 反向饱和电流; β : 电流增益

PS: 注意 β 表示的是集电极C的电流 I_C 比上基极电流 I_B 的比值

2.分段折线电路模型

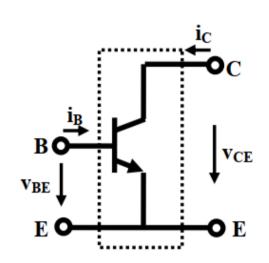
(只要元件约束方程有明显的分区特性,原理性分析中就可以使用分段折线模型)

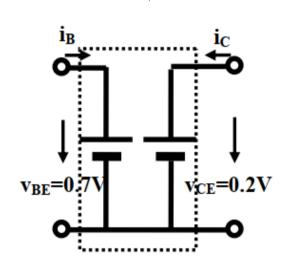
BJT伏安特性曲线在第一象限三个分区有明确的物理含义,可在三个区域分别线性化处理:

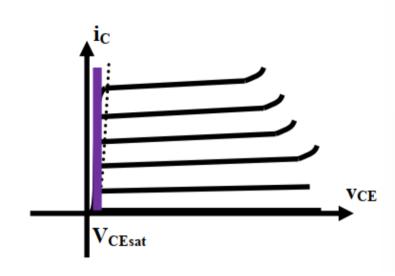
- 1.截止区: 发射结 (BE) 和集电结 (BC) 均反偏截止 (开路模型)
- 饱和区:发射结和集电结均正偏导通,集电极电流剧烈变化下集射电压 (V_{CE}) 几乎保持不变(0.2V),抽象为恒压源
- 恒流区:发射结正偏,集电结反偏,集电极收集到的载流子最多就是发射区发射到基区的载流子 (βI_B) ,集电极电流趋于恒定,伏 安特性曲线几乎水平, 抽象为恒流源。

每段的条件:

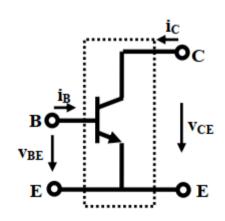
- 截止区 $i_B = 0, i_C = 0$
- 饱和区 $i_B>0, i_C<eta i_B$,此时 $V_{BE}=V_{on}=0.7V, V_{CE}=V_{CE,sat}=0.2V$

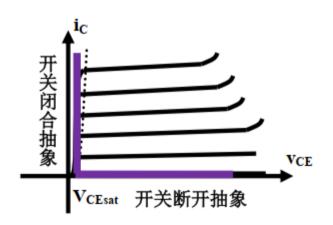






PS: 这里的"饱和"指的就是电压饱和 截止和饱和的切换可以抽象为开关模型:





条件: $i_B=0$

$$i_C = 0$$

BE结反偏, BC结反偏: 开关断开

i_B较大

$$v_{CE} = 0.2V$$

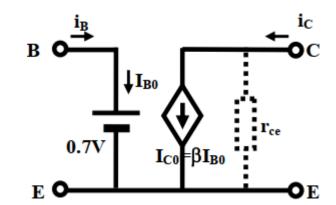
 $u_{CE} = 0.2V$ BE结正偏,BC结正偏:开关闭合 $i_c < eta_B$

很多应用情况下,小的饱和电压被忽略不计,建模为短路

• 有源区(恒流区) $I_B>0, V_{CE}>V_{CE,sat}=0.2V$ 此时

$$egin{aligned} V_{BE} &= 0.7V; \ i_C &= eta i_B (1 + rac{V_{CE}}{V_A}) = I_{C0} + rac{V_{CE}}{r_{ce}} \quad (r_{ce} = rac{V_A}{I_{C0}} = rac{V_A}{eta I_{B0}}) \end{aligned}$$

因此等效电路是恒流源(有厄利内阻 r_{ce}):



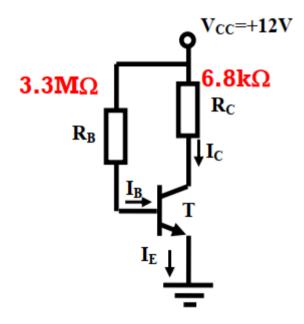
但是是否要考虑厄利效应带来的内阻,和CE端口外接的负载有关。如果外接电阻相对于内阻非常小就不需要考虑,否则就需要考虑。

为了将BJT作为恒流源使用,需要利用外接电压将BJT偏置到恒流区,但是因为BJT的一些参数变化比较大(比如电压增益β)导致需要使用一些电路结构(比如设计的负反馈结构)实现稳定的直流工作点。 下面默认分立BJT的β在200~450范围内

3.分压偏置电路分析

(数据采取图中所给的数据)

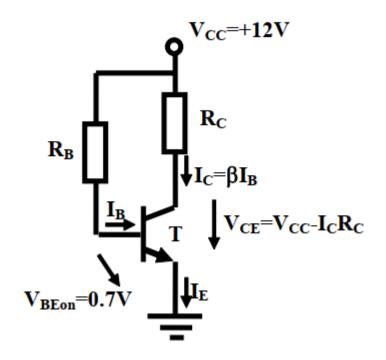
• 1.极简偏置



工作区假设:和分析二极管类似的,我们在不知道晶体管工作在哪个区域时,可以先假设它工作在某个区域,然后按这个区域的电路模型进行分析。显然假设工作在恒流区是最简单的,所以我们一般都首先假设晶体管工作在恒流区,然后计算检查 V_{CE} ,若 $V_{CE}>0.2V$,满足恒压区条件,说明假设成立,否则需要重新假设其他情况。

下面是分析极简偏置电路在恒流区假设下的结果:

$$V_{BE} = V_{BEon} = 0.7V$$



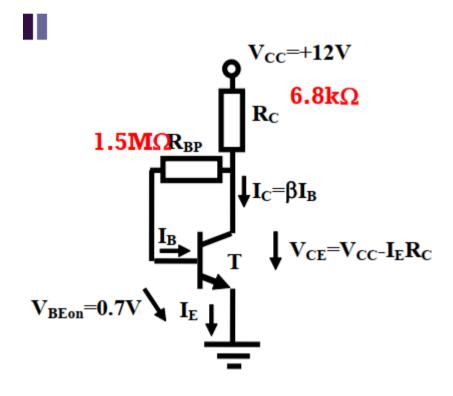
$$I_{\scriptscriptstyle B} = \frac{V_{\scriptscriptstyle CC} - V_{\scriptscriptstyle BE}}{R_{\scriptscriptstyle B}}$$

$$I_{C} = \beta I_{B} = \beta \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B}}$$

$$\begin{split} &V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \\ &= V_{CC} - \left(V_{CC} - V_{BE}\right) \frac{\beta R_C}{R_B} \end{split}$$

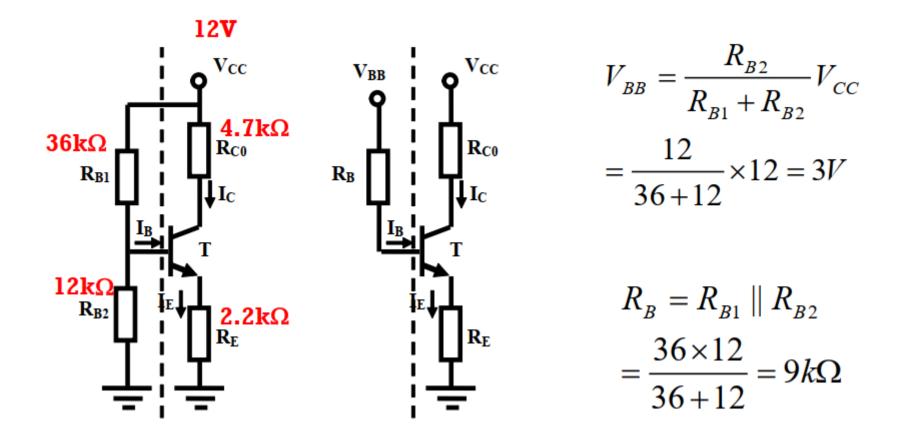
计算结果显示 β 在200~450的变化范围下, V_{CE} 在7.3V~1.5V范围变化,假设成立,但是工作点稳定性非常差。

• 2. 并联负反馈



计算得到 V_{CE} =6.6V~4.4V,提高了工作点的稳定性

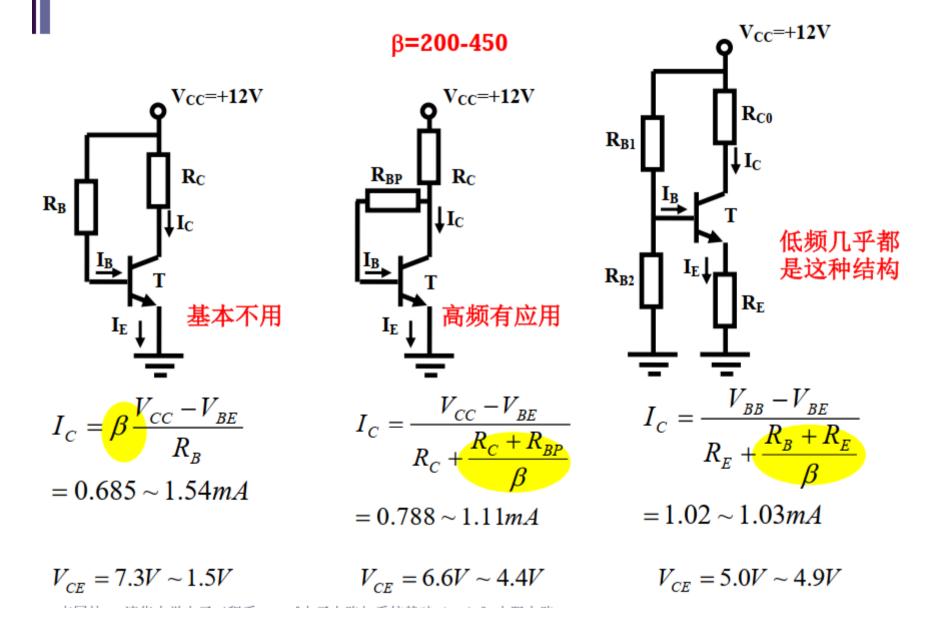
3.串联负反馈分压偏置电路:首先为了分析的简便,我们需要进行一次戴维南等效:



分析BE端口的看出情况,可以等效为一个戴维南源: $V_{BB}=3V, R_B=R_{B1}||R_{B2}=9K\Omega$ 然后分析得到 V_{CE} 在5.0V~4.9V范围内,非常稳定。

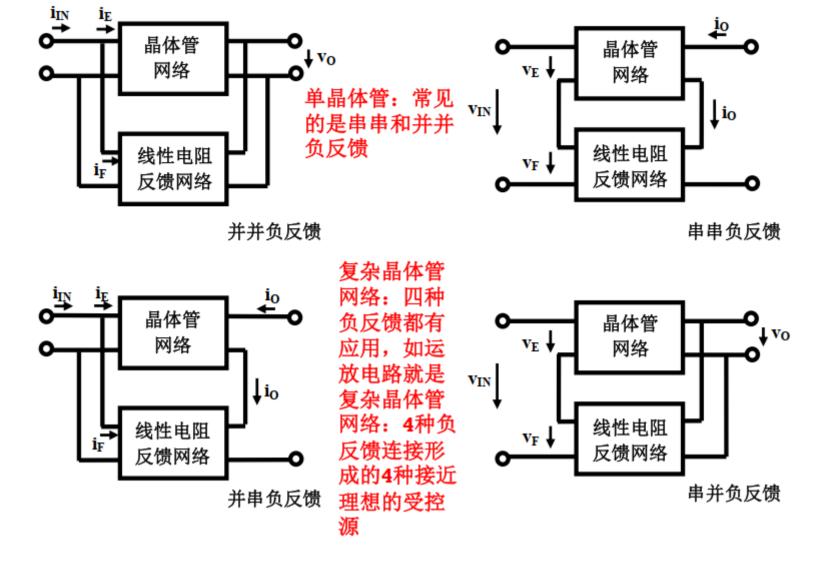
总结:

工作点确定性/稳定性差异巨大



4.负反馈电路连接方式与灵敏度分析

根据晶体管网络和线性电阻反馈网络两个端口的连接方式,可以分成四种(如下图):



单晶体管网络常见的是串串和并并负反,并串和串并需要多个晶体管才能实现(大概是这样)四种连接方式对应了四种(接近)理想的受控源:

(助记方法)

输出端口如果是并联,那么就是反馈网络检测输出电压,并且输出的就是电压(是x控压源),否则控制的是电流,(是x控流源);输入端口如果是并联,那么输入电压两个网络是相同的,所以反馈网络通过电流反馈形成负反馈机制,所以是(流控x源),否则是(压控x源)

更简洁的助记方法:

输出端口是检测端口, 所以输出端口什么相同就是?控什么源; 输入端口是控制端口, 所以输入端口什么不同就是什么控?源。

这样分析可知左上并并连接得到是流控压源。右上串串连接得到的是压控流源。

灵敏度分析:

灵敏度分析

$$S_{x_i}^y = \frac{\Delta y/y}{\Delta x_i/x_i} \stackrel{\Delta x_i \to 0}{=} \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

设计值 实际制作偏离设计值
$$y = f(x_1, x_2, ..., x_n) = f(x_{10} + \Delta x_1, x_{20} + \Delta x_2, ..., x_{n0} + \Delta x_n)$$

$$= f(x_{10}, x_{20}, ..., x_{n0}) + \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + ... + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n + h.o.t$$

$$\Delta y = y - y_0 \approx \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n$$

导致输出偏离设计值

$$\begin{split} \frac{\Delta y}{y_0} &\approx \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{x_{10}}{y_0} \frac{\Delta x_1}{x_{10}} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{x_{20}}{y_0} \frac{\Delta x_2}{x_{20}} + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{x_{n0}}{y_0} \frac{\Delta x_n}{x_{n0}} \\ \frac{\Delta y}{y_0} &= S_{x_1}^y \frac{\Delta x_1}{x_{10}} + S_{x_2}^y \frac{\Delta x_2}{x_{20}} + \ldots + S_{x_n}^y \frac{\Delta x_n}{x_{n0}} & \text{ 对于极度不稳定因素如β,电路设计时应确保其灵敏度足够小,从而提高系统稳定性} \end{split}$$

灵敏度:该因素对最终输出的影响力大小

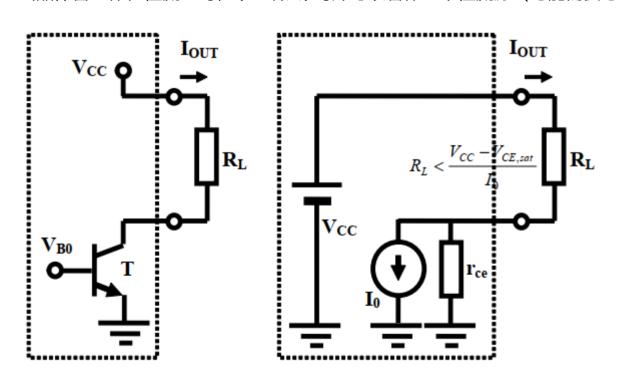
灵敏度:

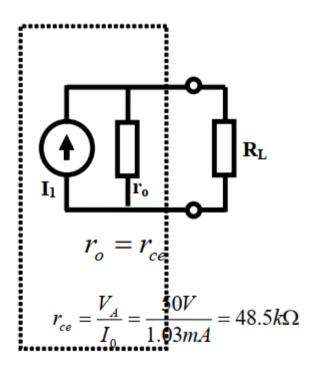
Def: 自变量误差程度对因变量误差程度的影响比例 根据定义可以求出:

$$egin{aligned} S_{x_i}^y &= rac{\Delta y/y}{\Delta x_i/x_i} \ \Delta x_i & o 0$$
时,上式 $o rac{x_i}{y}rac{\partial y}{\partial x_i} \end{aligned}$

5.电流源

当晶体管工作在恒流区时,(CE端口)对外可以看作一个恒流源(可能需要考虑厄利电阻)





上图是对晶体管恒流区外接电阻等效电路的抽象过程: 当 V_{B0} 不变时,晶体管相当于一个诺顿源,所以先做诺顿等效

• 首先明确外部电阻是接在最左图所示的部位的,此时 $I_{OUT}=I_C$,更具体的说:

$$I_C = eta A_J J_{BS0} \cdot \left(e^{rac{V_{BE}}{
u_T}} - 1
ight) \left(1 + rac{V_{CE}}{V_A}
ight) = I_0 \left(1 + rac{V_{CE}}{V_A}
ight) = I_0 + rac{I_0}{V_A} V_{CE} = I_0 + rac{V_{CE}}{r_{ce}}$$

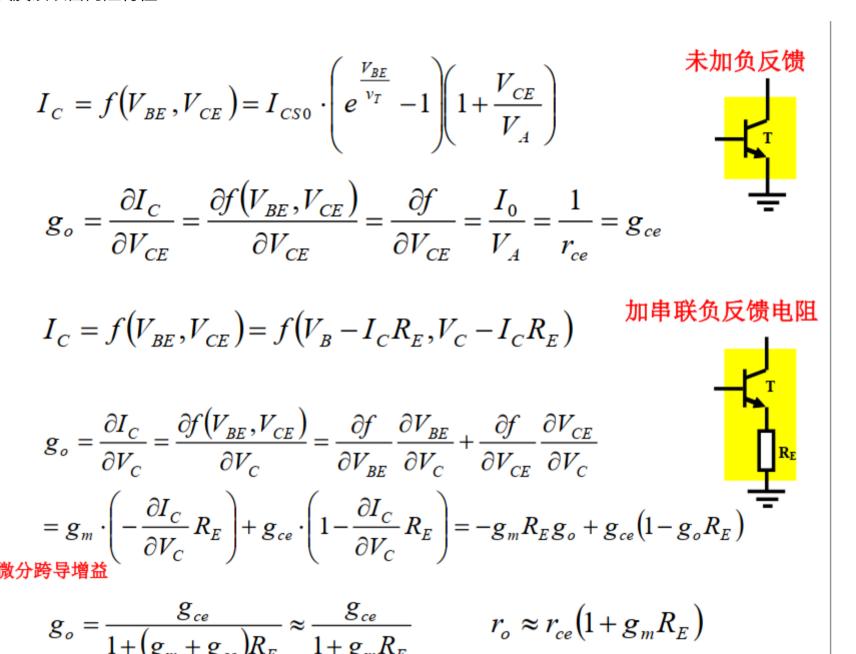
所以做诺顿等效得到中间的结构。

• 然后一个恒压源和一个恒流源串联,就相当于一个恒流源,进一步做诺顿等效(注意诺顿电流 I_1 除了晶体管等效的恒流源,还有 $rac{V_{CC}}{r_{ce}}$,内阻显然是 r_{ce})所以最终得到最右侧的等效结果: 所以加上负载电阻后:

$$egin{split} I_1 &= I_0 + rac{V_{CC}}{r_{ce}} \ I_{out} &= I_1 rac{r_{ce}}{r_{ce} + R_L} = rac{r_{ce}}{r_{ce} + R_L} I_0 + rac{V_{CC}}{r_{ce} + R_L} \end{split}$$

我们自然希望输出电阻越大越好,这样就能更接近理想恒流源。

• 负反馈改善内阻特性:



等效电流源内阻增加,

更加接近于理想恒流源/2024

相对于未加负反馈情况下的结果 $G_o = rac{I_0}{V_A} = g_{ce}$

清华大学电子工程系

加上了串联负反馈电阻的结果 $G_o pprox rac{g_c e}{1+g_m R_E}$,所以等效电流源的内阻更大了,更加接近理想恒流源。

《电子电路与系统基础(A1)》电阻电路

PS:添加负反馈也可以等效为增大 V_A (厄利电压)

PPS: 并且负反馈还能使得温度稳定性提高

$$\begin{split} I_C &= \beta A_J J_{BS0} \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) = I_0 \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) = I_0 + \frac{I_0}{V_A} V_{CE} = I_0 + \frac{V_{CE}}{r_{ce}} \\ I_0 &= \beta A_J J_{BS0} \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1\right) \qquad \qquad v_T = \frac{kT}{q} \end{split}$$

$$S_T^{I_C} = \frac{\partial I_C}{\partial T} \frac{T}{I_C} \approx -\frac{V_{BE}}{v_T} \approx -27$$

$$V_{BE}=V_{B0}$$

古经位要组度领域度报宜

$$S_T^{I_C} = \frac{\partial I_C}{\partial T} \frac{T}{I_C} \approx -\frac{V_{BE}/v_T}{1 + g_m R_E} \approx -0.3$$

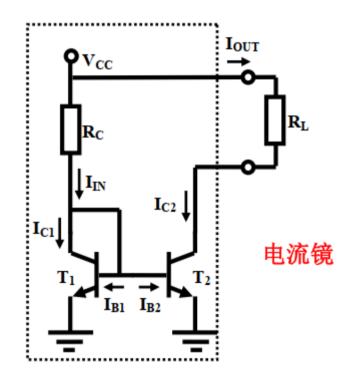
$$V_{\rm BE} = V_{\rm B} - I_{\rm C} R_{\rm E}$$

串串负反馈降低了温度敏感度

• 电流镜结构: 同属性抵偿

电流镜是模拟集成电路的特征电路,其可以实现非常理想的流控流源效果。

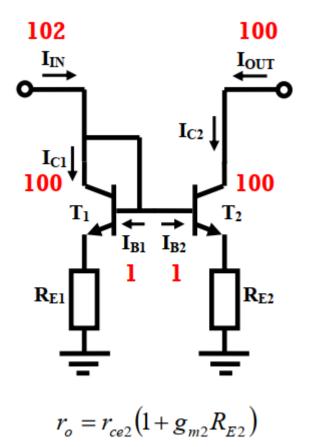
基本的电流镜结构:



$$G_{I} = rac{I_{OUT}}{I_{DN}} = rac{I_{C2}}{I_{C1} + I_{B1} + I_{B2}} pprox rac{I_{C2}}{I_{C1}} \ rac{I_{C2}}{I_{C1}} = rac{eta A_{J2} J_{BS0} \cdot \left(e^{rac{V_{BE2}}{
u_T}} - 1
ight) \left(1 + rac{V_{CE2}}{V_A}
ight)}{eta A_{J1} J_{BS0} \cdot \left(e^{rac{V_{BE1}}{
u_T}} - 1
ight) \left(1 + rac{V_{CE1}}{V_A}
ight)} pprox rac{A_{J2}}{A_{J1}}$$

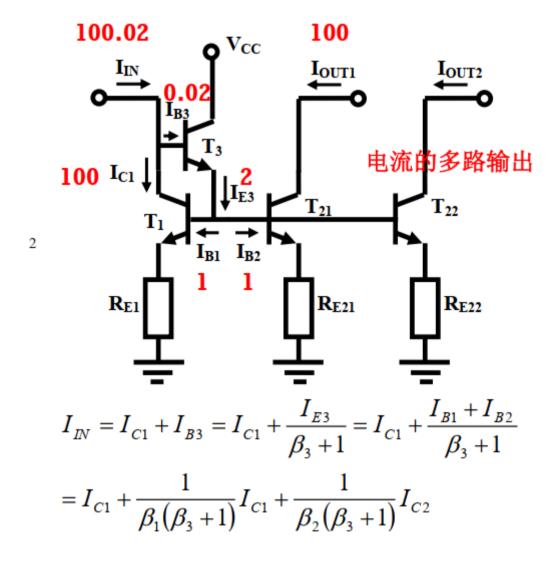
PS:这两次近似分别要求 β 足够大以及 V_A 足够大,这样匹配程度才够高

- 提升两条支路的匹配度:
- 1.使用负反馈



原理:根据上面的负反馈相当于增加了厄利电压 V_A ,显然可以提升匹配度。

• 2.使用eta倍增器(eta-help)



显然 $\beta - help$ 可以增大匹配度。

BJT小结: